

박람회 여비 신청서

소 속 대 학					
대 학	학부(과)	학 번	학년	성 명	연 락 처
IT 융합대학	전자공학부(전자공학전공)	2019	4	이소연	010-8359-3399
신 청 사 항					
참여한 박람회명	국제 병원 및 의료기기 산업 박람회				
박람회 참여 날짜	2022.09.29				
박람회 입장료	사전예약				
교통비	40200원				

※ 별첨 : 박람회 소감문 및 기타 증빙자료(영수증)

위와 같이 박람회를 참여하였으므로 여비 지급을 신청합니다.

2022년 10 월 04 일

신청인 이소연 이(연)

AI융합대학사업단장 귀하